

Dopo aver studiato l'articolo *AMDzen3.pdf* tratto dalla rivista *PC Professionale*, gennaio 2021, n. 358, gli studenti, a gruppi, scrivano una breve relazione (da minimo 2 a massimo 3 pagine, incluse due figure ed una tabella) sui nuovi processori AMD.

Aiutandovi con massimo 2 immagini ed una tabella, organizzate la vostra relazione soffermandovi su questi concetti:

1. Descrivere l'approccio *Multi Chip Module (MCM)* (o *Chiplet Design*) del processore AMD Zen3. Soffermarsi nello spiegare il significato ed il ruolo dei chiplet *Core Chiplet Die (CCD)* e *Chiplet I/O Die (cIOD)*.
2. Individuare i vantaggi dell'MCM.
3. Riassumere cosa migliora nella microarchitettura Zen 3 rispetto alla microarchitettura Zen 2. *Suggerimenti:* bus, *Instructions Per Cycle (IPC)*, CCD, Watt, Cache.
4. Compilare la tabella sottostante per mettere a confronto i microprocessori Rayzen 9 5950X, Rayzen 9 5900X, Rayzen 7 5800X e Rayzen 5 5600X.
5. Usando la tabella, individuare le differenze tra i vari microprocessori. Inoltre, indicare quale di questi sarebbe più adatto per un portatile.

	Rayzen 9 5950X	Rayzen 9 5900X	Rayzen 7 5800X	Rayzen 5 5600X
Socket				
Arch.				
Nome in codice				
Tech. produttiva				
Num. chiplet				
Core/Thread				
Freq. base				
Freq. turbo				
TDP ¹				
Prezzo				

¹ TDP = *Thermal Design Power*: indicazione del calore (potenza termica) dissipato da un microprocessore.

Tabella 1: Confronti tra le famiglie Rayzen con microarchitettura Zen3.